

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年9月10日(2015.9.10)

【公開番号】特開2014-27156(P2014-27156A)

【公開日】平成26年2月6日(2014.2.6)

【年通号数】公開・登録公報2014-007

【出願番号】特願2012-167296(P2012-167296)

【国際特許分類】

H 01 L 33/48 (2010.01)

H 01 L 33/22 (2010.01)

【F I】

H 01 L 33/00 4 0 0

H 01 L 33/00 1 7 2

【手続補正書】

【提出日】平成27年7月24日(2015.7.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

パッケージ基板と、

前記パッケージ基板上に実装され、半導体積層構造を有し、個々の形状が長方形である複数のLEDチップと、

前記複数のLEDチップを封止する樹脂と、を有し、

前記複数のLEDチップは互いに隙間なく密着し1つの集合体を形成し、

前記集合体の形状は円または橢円である、

ことを特徴とするLEDパッケージ。

【請求項2】

前記集合体の周辺部に光散乱剤を含む光散乱樹脂をさらに設けた、請求項1に記載のLEDパッケージ。

【請求項3】

前記光散乱樹脂は前記集合体の周辺部の凹凸に合わせて配置されている、請求項2に記載のLEDパッケージ。

【請求項4】

隣接する半導体積層構造間に形成された間隙に光散乱剤を含む光散乱樹脂をさらに設けた、請求項1乃至3のいずれか一項に記載のLEDパッケージ。

【請求項5】

前記LEDチップを構成するLED基板の外周部に凹凸が形成されている、請求項1乃至4のいずれか一項に記載のLEDパッケージ。

【請求項6】

前記集合体の周辺部及び隣接する半導体積層構造間に形成された間隙に設けられ、前記集合体の表面に平坦な面を形成する平坦化層と、

前記平坦化層上に形成された蛍光体層と、

をさらに有する、請求項1に記載のLEDパッケージ。